

半导体产业新闻半月刊（精华版）

2018/1022-2018/1104



专题分类



并购投资

- 点评：
- ① 华大借路积塔，收下先进半导体。
 - ② 格芯成立全资子公司Avera Semi，专注ASIC产品。
 - ③ 半导体行业再现蛇吞象并购，闻泰科技取得安世集团控制权。
 - ④ 意在IGBT，中环股份与格力、中车等拟组建合资公司。



领域	时间	事件	原因/内容	资金(美元)
IC制造	2018/10/30	积塔半导体与先进半导体宣布合并	资源整合。 双方合并完成后,各方面同时进行整合,能够为先进提供资金支援以及其他行业资源。	
IC制造	2018/10/31	格芯成立子公司Avera Semi	业务重组。 以更好地施展格芯在ASIC设计和IP方面的强大背景。	
IC封测	2018/10/25	晋华入股福建矽品	深化合作。 深化福建矽品与主要客户间的产销合作关系。	一期0.225亿
分立器件	2018/10/24	闻泰科技将收购安世半导体75.86%的股份	战略收购。 增强闻泰在半导体方面的技术实力。	36亿
存储器	2018/10/30	赛普拉斯与海力士携手组建NAND闪存合资公司	强强联手。 合资公司将生产及销售赛普拉斯现有的SLC NAND闪存系列产品,并将继续投资于下一代NAND产品。	
IGBT	2018/10/31	中环股份与格力、中车等拟组建合资公司	协同创新。 打造功率半导体器件与应用全产业协同创新基地。	注册资本0.72亿



本土产业

- 点评：
- ①持续扶持集成电路产业，河南、南京再设产业基金。
 - ②地方集成电路产业建设如火如荼，宁波、南京、成都、郑州等地多个项目量产或开工。
 - ③中国存储器产业联盟成立，刁石京任理事长。



【国家集成电路产业投资进度提前9个月】

10月22日，华芯投资在其官方微信平台上公布，截至2018年9月12日，国家集成电路产业投资基金有效承诺额超过1200亿元，实际出资额达到1000亿元，投资进度与效果均好于预期，预计2018年年底将基本完成首期规模的有效承诺，投资进度总体提前9个月。

【河南设立100亿元信息产业专项基金，首期基金有望下月发行】

近期，河南设立100亿元信息产业专项基金，重点支持国家大数据企业，扶持电子信息产业。目前，河南信息产业发展基金正在组团队、建机构、定机制、立规矩，基金首批近20个拟投资项目基本储备完成。

【50亿元高端装备产业基金落户南京】

10月29日，南京浦口高端装备产业基金正式签约，该基金由南京浦口高端装备产业基金由浦口经济开发区、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、海林投资三方共同组成，规模为50亿元人民币。

【福建再推“强芯计”】

近日，福建出台了《福建集成电路产业发展行动计划1.0版》，重点强调了集成电路产业的规划，提出加快实施“增芯”工程。在“推进计划”中，福建规划超千亿元的重大产业集群，包括集成电路和光电产业等27大产业集群。到2020年，力争培育形成20个以上产值（营业收入）超千亿元的重大产业集群。



【宁波中芯特种工艺产线量产、多个集成电路项目动工】

SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台

11月2日，中芯集成电路(宁波)有限公司200mm特种工艺(晶圆/芯片)N1产线正式投产，同时，中芯宁波N2项目、南大光电与安集微电子等三个项目也正式动工。

【台积电南京厂正式量产】

台积电中国南京晶圆十六厂近日举行开幕暨量产典礼。台积电南京董事长何丽梅梅指出，该厂是台积电最美的晶圆厂，也创下建厂最快、上线最快等台积电多项纪录，2020年月产能将扩增至两万片规模。

【成都偏光片“超级工厂”正式开工】

- ① 近日，深圳兴飞科技有限公司在成都新津建设的西部首个偏光片超级工厂项目已正式开工。
- ② 该项目投资100亿元，分三期建设年产8000万平方米偏光片超级工厂及相关项目，打造光电显示配套全产业链。



【苏州晶台光电二期建成投产】

- ① 10月24日，深圳市晶台股份有限公司旗下全资子公司苏州晶台光电有限公司在张家港举行二期投产仪式及Mini LED新品发布会。
- ② 据悉，苏州晶台二期总投资超过15亿元，生产线1400余条，主要生产小间距和Mini LED产品，将实现月产能10000KK，预计年产值达20亿元。

【徐州将再建一座晶圆厂】

江苏鑫华半导体材料科技有限公司副总经理张晓栋表示，作为拥有国内规模最大电子级多晶硅生产线的企业，该公司对徐州集成电路与ICT产业未来的发展充满信心。准备再投资160亿元建设12寸/8寸晶圆项目，填补国内半导体级多晶硅生产技术空白。全部投产后可实现年产值100亿元。

【福州软件园闽侯分园揭牌】

- ① 10月21日，福州软件园闽侯分园举行揭牌暨招商项目签约仪式，该园区将聚焦于大数据、人工智能、区块链、信息安全、集成电路设计等七大领域。
- ② 在仪式举行当天，29家企业成功签约入驻该园区，总投资约32亿元，其中包括北京比特大陆科技有限公司。



【格芯取消成都厂180nm/130nm项目投资】

格芯将取消成都工厂（180nm/130nm）原项目一期投资。与此同时，格芯与成都合作伙伴已经签署了投资合作协议修正案，将修订项目时间表，以更好地调整产能，重点聚焦22FDX技术。

【中国存储器产业联盟成立, 刁石京任理事长】

近日，中国存储器产业联盟成立大会暨第一次会员大会在武汉举办。工业和信息化部副部长罗文出席大会并致辞，宣布中国存储器产业联盟正式成立。

【合晶郑州新厂启用】

硅晶圆大厂合晶近日举行郑州新厂启用典礼，第一阶段为月产能20万片的8寸产能，明年正式量产后，全年产值可望达5亿人民币。

【ABB中国新工厂落“沪”，建设其全球最大机器人工厂】

10月27日，ABB宣布将投资1.5亿美元（约10亿人民币）在上海康桥新建一座全球领先的机器人工厂，实现用机器人制造机器人。

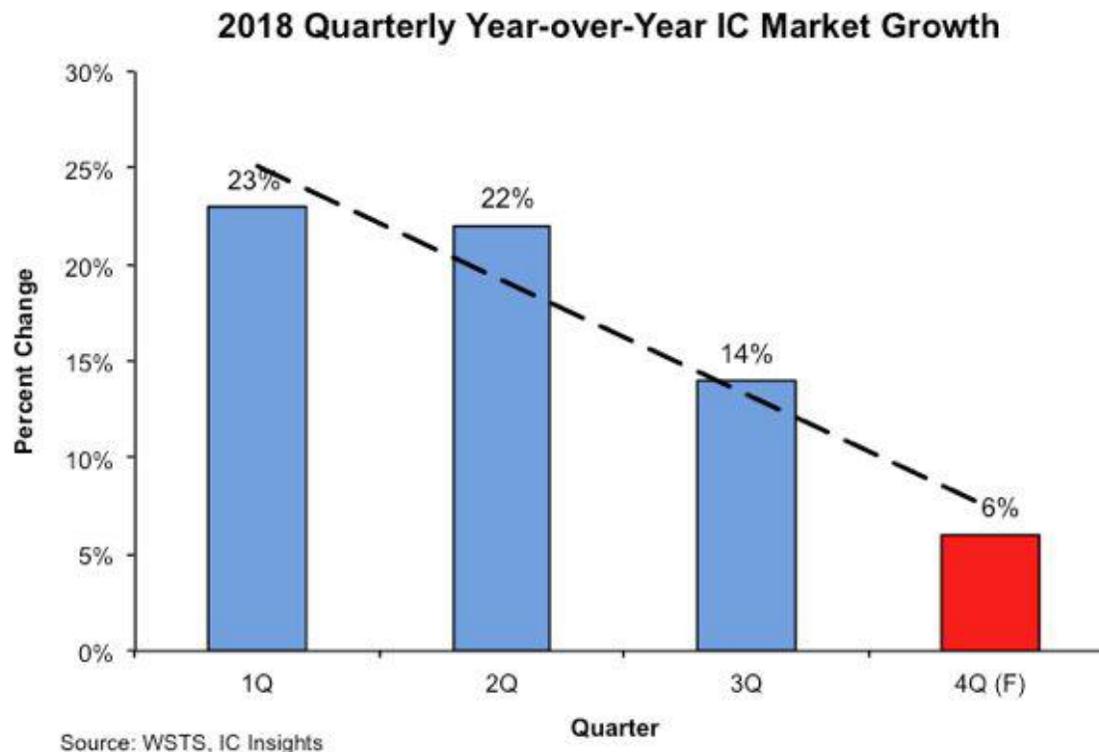


市场数据

- 点评：
- ① IC市场Q4增速降至6%，半导体产业进入周期性降温。
 - ② 2018年中国10大IC设计企业榜单出炉：海思依旧第一，豪威科技冲到第二。
 - ③ 得益于新的光学成像应用，OSD销售2019年将创纪录。



【IC Insights: IC市场Q4增速降至6%】



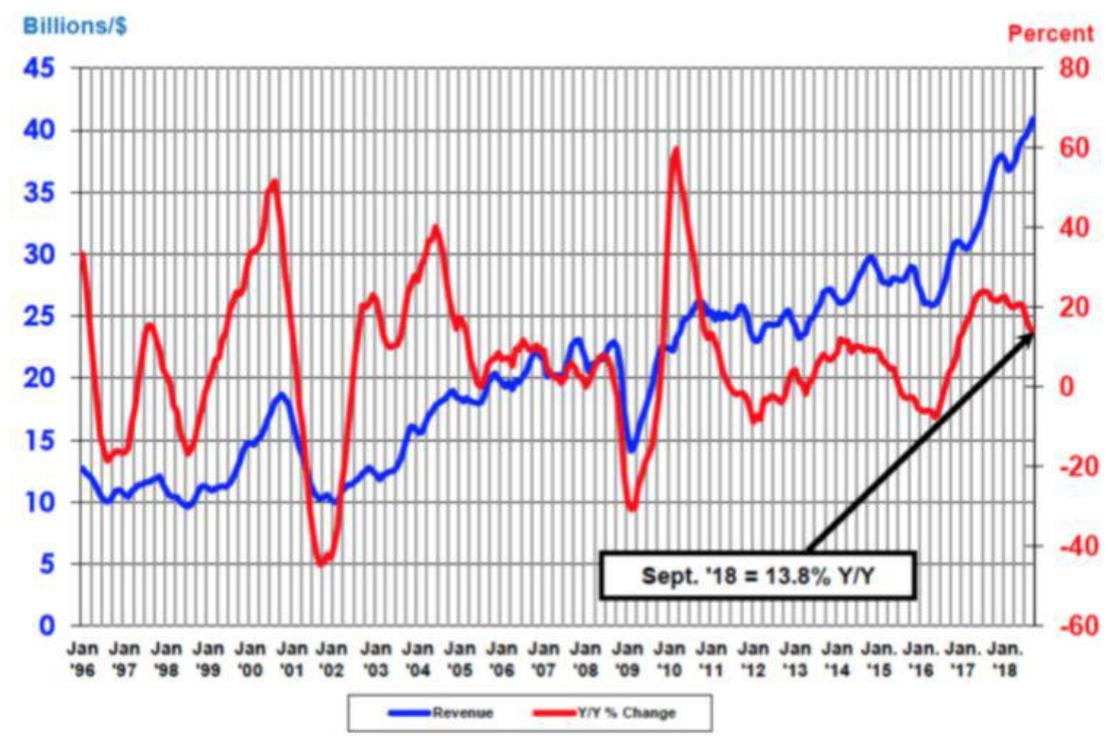
- ① IC Insights称，对于2018年的第四季度的IC市场增速预测从第一季度的23%下降到了6%。
- ② 2018年上半年开始，IC市场的季度同比增长强劲。然而，第三季IC市场同比增长率降至14%。此外，随着存储器市场的疲软，预计第四季度IC市场同比增长率仅为6%。



【SIA: 半导体销售额9月创新高】

Worldwide Semiconductor Revenues

Year-to-Year Percent Change



Source: WSTS

SIA称，2018年9月份全球半导体销售额为409亿美元。和前月相比，销售额上升2.0%；和去年同期相比，销售额上升13.8%。



【2018年中国10大IC设计企业榜单出炉】

2018年
中国十大集成电路设计企业预测

排名	公司
1	海思
2	豪威科技
3	紫光展锐
4	比特大陆
5	汇顶科技
6	芯成
7	华大半导体
8	敦泰
9	兆易创新
10	紫光国微

数据来源：芯谋研究ICWise，
《2018年上半年中国IC设计产业报告》

《2018年国内十大设计公司》：
海思依旧第一，
豪威科技罕见冲到第二，
紫光展锐第三，
比特大陆第四，
汇顶科技第五位。



【小米力压三星成印第一大手机品牌】

India smartphone shipments, market share and annual growth (by vendor),
Canalys Smartphone Market Pulse Q3 2018

Vendor (company)	Q3 2018 shipments (million)	Q3 2018 market share	Q3 2017 shipments (million)	Q3 2017 market share	Annual growth
Xiaomi	12.1	29.8%	9.2	22.5%	31.5%
Samsung	9.3	23.0%	9.4	23.1%	-1.6%
Vivo	4.5	11.1%	4.0	9.8%	12.3%
Oppo*	3.6	8.8%	3.6	8.9%	-2.0%
- Realme	0.8	1.9%	-	-	N/A
Micromax	2.6	6.3%	1.6	3.9%	61.5%
Others	8.5	21.0%	13.0	31.8%	-34.7%
Total	40.4	100.0%	40.8	100.0%	-0.9%

在截至9月30日的第三季度，小米印度智能手机出货量超过1200万部，同比增长30%；三星以930万部出货量排在第二位，同比减少2%。



【预计2018年我国传感器市场规模将达到1472亿元】

- ① 据前瞻产业研究院发布的《传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》预测，2018年我国传感器市场规模将达到1472亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为12.13%，预计到了2022年中国传感器市场规模将达到2327亿元。

【未来五年VCSEL市场年复合增长率达16.9%】

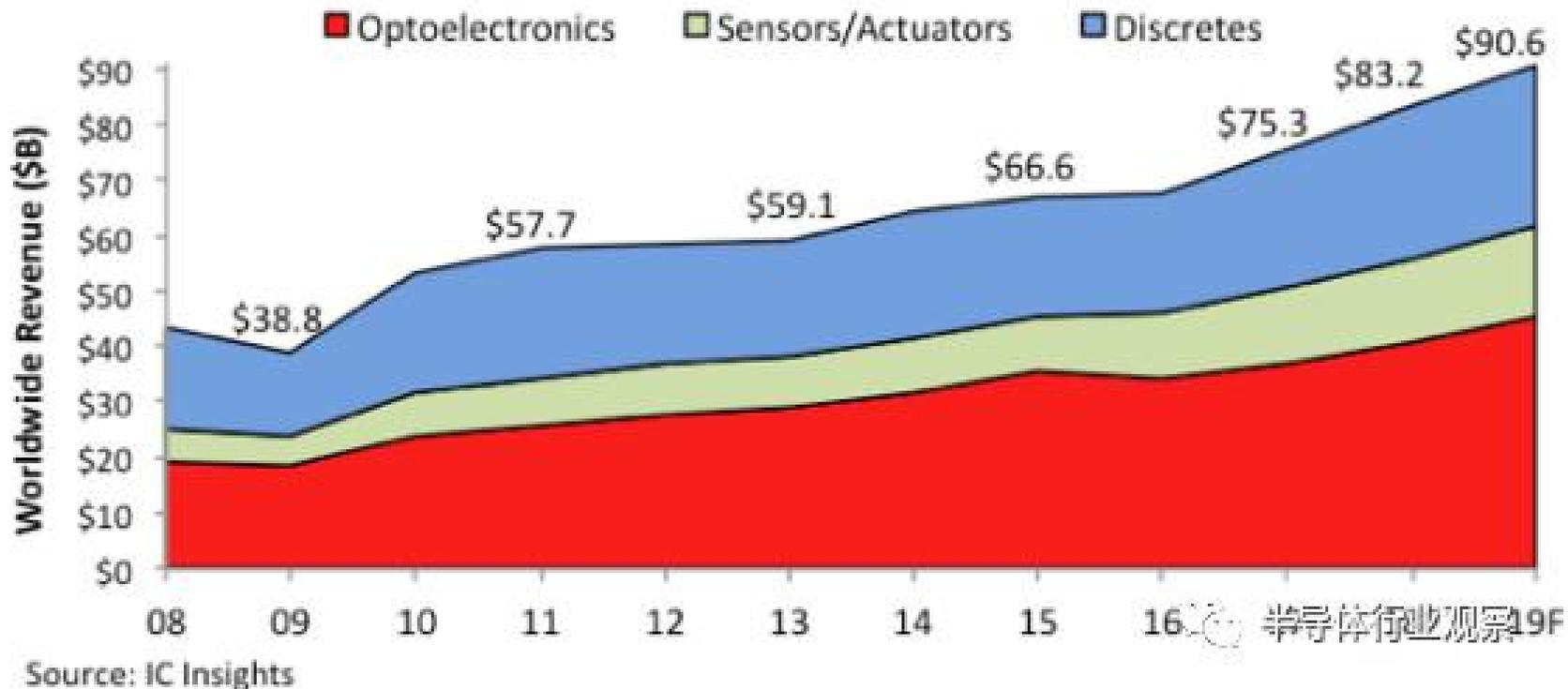
Markets and Markets的2018年VCSEL市场报告显示，垂直腔面发射激光器（VCSEL）市场的年复合增长率（CAGR）将从2018年的17.8亿美元增加到2023年的38.9亿美元，年复合增长率（CAGR）为16.9%。

增长主要归功于VCSEL在接近传感和医疗、数据通信、红外照明等应用中的使用日益增加，以及随着汽车电子技术的进步对VCSEL的需求激增。然而，有限的数据传输范围限制了VCSEL市场的增长。



【OSD销售2019年将达到创纪录的906亿美元】

O-S-D Segments Lift Combined Sales to Another All-Time High



IC Insights预测，今年光电子、传感器和致动器以及分立半导体（OSD）这三个细分市场的总销售额将达到832亿美元，到2019年，继续增长9%，预计收入将达到创纪录的906亿美元。



产业合作

点评：①发力5G，II-VI和Sumitomo将共建碳化硅基氮化镓晶圆制造平台。
②IMEC联手ASML，布局post-3nm微影技术。



领域	合作公司/单位	目的
化合物半导体	II-VI和Sumitomo	建立垂直整合的150mm晶圆制造平台，用于制造下一代5G无线网络的碳化硅基氮化镓高电子迁移率晶体管（HEMT）器件。
EUV	IMEC、ASML	正在联合建立一个新的实验室，以加速用于图案化半导体芯片的下一代极紫外（EUV）光学器件的开发。



设计制造

点评：①客户订单多，环球晶将投入4.38亿美元在韩扩产。
②索尼计划扩产图像传感器，以应对自动驾驶和物联网方面的巨大需求。



【环球晶圆将投入4.38亿美元在韩扩产】

为了满足客户端12英寸晶圆先进制程的新产能需求，环球晶圆在韩国天安市的现有晶圆厂MEMC Korea Co. 将扩增一条月产能目标为15万片的晶圆产线，预计投资金额达4.38亿美元。

【索尼将扩增2-3成图像传感器产能】

索尼计划将在未来三年内投资6000亿日元（合约53.4亿美元）到以图像传感器为主的半导体产能扩增中，以此来应对未来自动驾驶技术和物联网方面的巨大需求。



产品应用

点评：①EDA、存储器、传感器、消费电子领域火热，各厂商纷纷推出新产品。



领域	公司/单位	产品及特性
IC设计	芯原微电子	面向物联网推出基于GLOBALFOUNDRIES 22FDX® FD-SOI工艺的超低功耗BLE 5.0 RF IP
EDA	华大九天	发布了GPU-Turbo异构仿真系统Empyrean ALPS-GT、超高速Monte Carlo分析解决方案Empyrean Mcfly、AI-powered IP质量验证方案Empyrean Qualib三大新品。
存储器	日本富士通	推出汽车用FRAM器件MB85RS64VY的工程样品。该FRAM的温度范围高达125° C，具有64Kbit的存储器和SPI接口，最高工作频率为33MHz。
智能监控芯片	国科微	推出一代智能监控GK720x系列芯片及解决方案。GK720x系列芯片均内置国科微第三代ISP，支持smart H265和H264编解码，具有低功耗、低照度、低码率、低成本、高集成度等特点。
传感器	三星	发布两款新的ISOCELL CMOS传感器，分别是4800万像素的Bright GM1和3200万像素的Bright GD1。
MEMS	日本村田	基于微型微机电系统（MEMS）技术，村田新推出的谐振器具有稳定的频率特性，在-30至85° C的工作温度范围内温度漂移<160ppm。起始频率精度为±20 ppm，达到更复杂（和昂贵）晶体谐振器的预期水平。
AI	IBM	推出“IBM安全连接”（IBM Security Connect），把供应商、开发商、人工智能（AI）和数据连接到一起，以提高网络攻击事件响应速度，改善可信计算能力。
IOT	ST	推出超低功耗的工业资产管理Sigfox解决方案，让全球物联网设备实现无缝连接。
消费电子	苹果	苹果正式发布了新款的 MacBook Air、Mac mini 以及 iPad Pro。
消费电子	柔宇科技	发布了全球首款折叠屏手机——FlexPai柔派，它采用高通骁龙基于台积电7nm工艺的骁龙8系SoC，采用2000万+1600万广角长焦双摄规格，辅以6GB/8GB运存+128GB/256GB/512GB，同时引入可提升40%的充电速度的柔充技术，1小时最多可充满80%的电量。



大国重器

点评：①欧盟委员会启动量子旗舰计划，旨在将量子物理研究从实验室转移到商业市场。
②采用板间高速互联方案，中科曙光发布全球首款液冷八路服务器。



【欧盟委员会启动量子旗舰计划】

- ① 近日，欧盟委员会宣布了量子旗舰计划将投资10亿欧元（11亿美元）的资金以支持大规模和长期的研究和创新项目，旨在将量子物理研究从实验室转移到商业市场。
- ② 该计划将主题分为五个主要研究领域：量子通信（QComm）、量子计算（QComp）、量子模拟（QSim）、量子计量与传感（QMS）和基础科学（BSci）。

【中科曙光研制出我国首款液冷八路服务器】

近日，中科曙光成功研制出我国首款液冷八路服务器，该服务器具有绿色降噪、性能卓越、稳定可靠、可便捷部署运维等优点。



人事变迁

点评：①为削减成本，通用汽车计划遣散1.8万名老员工。



【通用汽车计划遣散1.8万名老员工】

通用汽车(GM)希望1.8万位员工自愿离职，以便将资金用于未来电动及自驾车的投资，离职员工将依买断方案给予资遣费。该公司表示这项措施是为了接下来可能面临的事件做准备，例如北美及中国销售减缓、物价、关税等问题。



焦点关注

点评：①福建晋华表态被美制裁事件：坚定不移地走自足研发的道路。



【福建晋华表态被美制裁事件】

福建省晋华集成电路有限公司在其官网发表声明，全文如下：

- ① 晋华公司始终坚定走自主研发路线，不断加大投入，开展内存存储器关联产品的研发、制造，取得了一批专利成果。晋华公司始终重视知识产权保护工作，不存在窃取其他公司技术的行为。
- ② 美光公司把晋华的发展视为威胁，采取各种手段阻止、破坏晋华的发展。美方将晋华列入美出口管制“实体清单”，并采取司法措施。对此，晋华公司坚决维护企业的合法权益，要求对方立即停止错误做法，便利和促进双方企业开展正常的贸易与合作。



专利要闻

点评：①3D打印、汽车电子、消费电子、VR领域竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。



类别	公司/单位	事件内容
新专利	苹果	三角镶嵌3D打印方法获得专利。
新专利	苹果	汽车专利曝光：可通过车身发光装置向周围传递复杂信息。
新专利	苹果	新专利：设计电动车高低压电转换器。
新专利	索尼	新专利：研究手部追踪技术 真正动手玩游戏。
新专利	亚马逊	智能音箱新专利：告诉用户是否抑郁，并推销药物。
新专利	三星	三星折叠屏平板专利曝光：可向内或向外翻折。
新专利	Oculus	新专利：提出定向波束无线PC VR解决方案。
新专利	谷歌	新专利：或打造交互式智能服饰。
纠纷	大众汽车、博通	大众汽车被告专利侵权，博通寻求10亿美元赔偿。



SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



联系我们

SEMI中国 Lily Feng
Tel: +86-21-60278500
E-MAIL: lifeng@semi.org
<http://www.semi.org.cn/siip>

订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取
(来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话)
SEMI中国 Lily Feng
E-MAIL: lifeng@semi.org

